

## 丸文とワイ・イー・データが販売提携

### — 300ミリウェハ対応レーザーマーリング装置・読み取り装置 —

エレクトロニクス専門商社の丸文株式会社（社長：佐藤 敬司、本社：東京都中央区、資本金：62億1,450万円、以下 丸文）と株式会社ワイ・イー・データ（取締役社長 石川 勲、本社：埼玉県入間市、資本金：50億円、以下 YE データ）は、YE データが開発した 300 ミリウェハ対応レーザーマーリング装置と読み取り装置の販売で提携しました。

次世代 300 ミリウェハラインを見据えた大口径化への対応として、ウェハマーリング分野においては、低パーティクル、高クリーン、高精度・高視認性マーリングなどの技術に加え、ロジックやシステム LSI 等の高付加価値デバイスに対するトレーサビリティのためのダイ管理マーリング技術が要求されています。丸文と YE データの販売提携は、YE データの開発した 300 ミリウェハの表裏面全面にマーリングが可能なダイマーリング装置をはじめ、出荷時マーリング・工程管理マーリング向けマーリング装置や読み取り装置を組合せ、2003 年度より本格的な立ち上がりが見込まれる 300 ミリ市場に向けて拡販していくことが狙いです。

丸文はこれまで、北米やドイツの最先端レーザ発振器やレーザ加工機を輸入販売する一方、半導体前工程においては、化合物半導体用の MBE 装置や MOCVD 装置を、後工程では、インライン向け IC 外観検査装置やバーンインテスタなどの検査・製造関連装置を取り扱い、販売してきた実績を持っています。丸文と YE データは、丸文の持つ日本国内 10ヶ所の販売ネットワークと技術サポート専門会社を活用し、販売協力していきます。また、両社はさらに、今後需要が見込まれるレーザ応用製品の製品化に関しても、幅広く業務提携をしていく考えです。

丸文では、これまで培ってきたレーザコア技術をベースに、今後はレーザの新しい応用分野として期待される産業用加工分野に対して、レーザ加工装置ビジネスをシステム事業の一つの柱として成長させていく考えです。

YE データはこれまで、レーザマーリング、読み取り装置の販売については、液晶の生産設備向けや大手半導体メーカーへ納入してきました。同社の特長は、レーザマーリング装置と読み取り装置を組合わせることで、お客様の生産システムに最適なカスタム装置設計による半導体前後工程マーリング設備を提供できることです。YE データとしては丸文を国内初の販売代理店とし、300 ミリウェハ用レーザマーリング装置と読み取り装置の販売活動を強化し、レーザマーリングシステム事業の拡大を目指します。

### <丸文株式会社について>

本 社 : 東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設 立 : 1947 年

代表者 : 代表取締役社長 佐藤 敬司

従業員 : 932 名 (2003 年 4 月現在)

資本金 : 62 億 1,450 万円

売上高 : 1,517 億円 (2003 年 3 月期連結)

事業概要 : 集積回路を中心とした半導体、電子応用機器など、国内外の最先端エレクトロニクス  
製品を販売する専門商社。東京証券取引所市場第 1 部に上場。(コード番号 : 7537)

丸文株式会社の詳細については、[www.marubun.co.jp](http://www.marubun.co.jp) をご覧ください。

### <株式会社ワイ・イー・データについて>

本 社 : 埼玉県入間市新光 182 番地

設 立 : 1973 年

代表者 : 取締役社長 石川 獻

従業員 : 172 名 (2003 年 3 月現在)

資本金 : 50 億円

売上高 : 91 億円 (2003 年 3 月期連結)

事業概要 : コンピュータ周辺機器の開発・製造・販売およびデータリカバリー事業  
東京証券取引所市場第 2 部に上場。(コード番号 : 6950)

株式会社ワイ・イー・データの詳細については、[www.yedata.co.jp](http://www.yedata.co.jp) をご覧ください。

### ニュースリリースに関するお問い合わせ先

丸文株式会社 広報室

担当 : 蟹沢 (カニサワ)

中央区日本橋大伝馬町 8-1 〒103-8577

TEL: 03-3639-9803

FAX: 03-5644-7693

E-mail: [kanisawa@marubun.co.jp](mailto:kanisawa@marubun.co.jp)

## 製品資料 1

### 半導体ウェハ用レーザーマーキング装置の概要

本製品は、シリコンウェハの表裏全域面にX-Yステージを使わず任意の位置に任意のIDをYAGグリーンレーザを使用して印字する装置です。従来、半導体業界ではパーティクルの発生を最小限に抑えたソフトマーキング装置を使用していましたが、刻印が浅いため、視認性が劣化し、工程の途中で再度マーキングが必要となることがありました。このレーザマーキング装置は、安定性の高いYAGグリーンレーザとYEデータ独自の技術で、深さ10ミクロンを超えるマーキングを実現しました。

また、トレーサビリティ、不正コピー（海賊版）等の防止などの観点から、ダイマーキング装置を製品化いたしました。同社独自の技術でX-Yステージを使わず、300ミリウェハ裏面全域を一筆書きができ、装置の小型化、高スループットを実現。また、薄厚ウェハー搬送技術と信頼性の高いYAGグリーンレーザでお客様のニーズにお応えいたします。

安川電機グループの豊富な経験と技術をもとに、お客様の生産システムに最適なカスタム装置設計によるレーザマーキング装置を提供します。

### 主な特長

1. YAG (SHG) グリーンレーザにより、安定した高品質・高精度のマーキングを実現
2. ミニエンバイロメントによるクリーン度クラス1に対応
3. オープン／SMIF カスタム対応可能
4. 高性能クリーンロボットによる、高速・高精度のウェハハンドリング
5. SEMI-OCR、SEMI-2DCODE (T7) 規格の他、各種マーキングに対応

### 製品の主な仕様（マーキング装置の例）

YD-W2600 シリーズ	
スキャン速度（個/h）	2000mm/秒
スキャンエリア	300mm ウェハ全域
マーキングタイプ	ソフトマーキング
マーキングスピード	150 文字/秒
サイズ	2,000(W) × 1,200(D) × 2,000(H) mm(参考値)
重量	約 1.5t